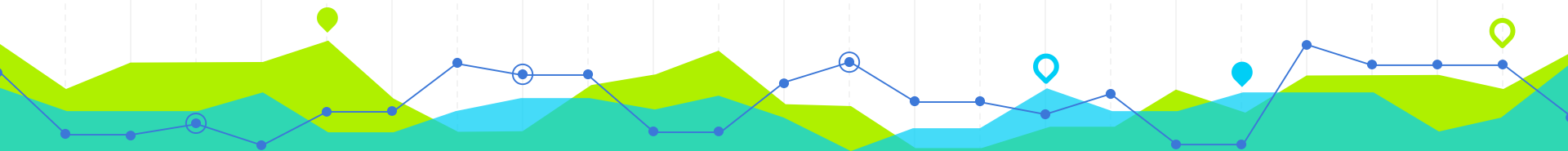




FATC 記憶體最佳代工夥伴



福懋科技 2021年法人說明會

執行副總經理暨發言人 張憲正

2021年8月12日



免責聲明

簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播、重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。



會議議程

1

2021年上半年營運績效及財務狀況

2

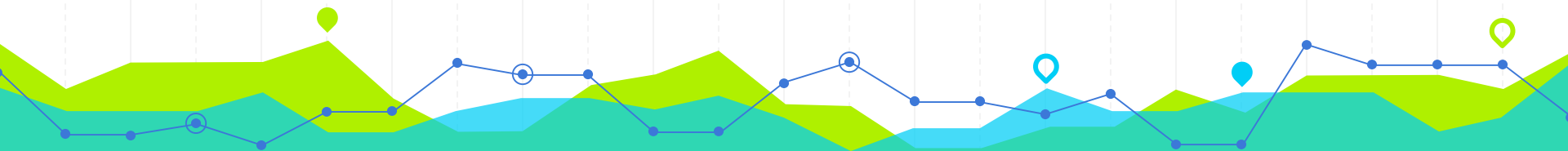
研究發展規劃

3

營運重點與市場展望

4

問與答



2021 年上半年 營運績效及財務狀況

1



2021年上半年財務摘要

單位:新台幣仟元

項目	2021年上半年		2020年上半年		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目						
營業收入	5,001,263	100.0	4,961,636	100.0	39,627	0.8
營業毛利	1,018,548	20.4	977,747	19.7	40,801	4.2
營業利益	914,612	18.3	879,142	17.7	35,470	4.0
稅前息前折舊攤銷前利益	1,636,148	32.7	1,740,875	35.1	-104,727	-6.0
稅前淨利	896,217	17.9	887,108	17.9	9,109	1.0
本期淨利	719,751	14.4	731,783	14.7	-12,032	-1.6
每股盈餘(元/股)	1.63		1.65		-0.02	
每股淨值(元/股)	26.16		24.34		1.82	



2021年各季綜合損益比較表

單位：新台幣仟元

項目	2021年Q2		2021年Q1		差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目						
營業收入	2,466,909	100.0	2,534,354	100.0	-67,445	-2.7
營業毛利	518,117	21.0	500,431	19.7	17,686	3.5
營業利益	465,456	18.9	449,156	17.7	16,300	3.6
稅前息前折舊攤銷前利益	810,190	32.8	825,958	32.6	-15,768	-1.9
稅前淨利	444,671	18.0	451,546	17.8	-6,875	-1.5
本期淨利	358,515	14.5	361,236	14.3	-2,721	-0.8
每股盈餘(元/股)	0.81		0.82		-0.01	
每股淨值(元/股)	26.16		27.83		-1.67	



2021年第2季與第1季差異說明

項目 會計科目	2021年Q2		2021年Q1		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
營業收入	2,466,909	100.0	2,534,354	100.0	-67,445	-2.7	營收季減2.7%，主要係銷售量減少7.53%，平均代工單價增加5.12%，匯率影響不利1.89%。
營業毛利	518,117	21.0	500,431	19.7	17,686	3.5	2021年Q2毛利季增3.5%，主要係代工單價增加5.12%所致。
營業利益	465,456	18.9	449,156	17.7	16,300	3.6	2021年Q2營業利益季增16,300仟元，主要為毛利增加17,686仟元、推銷管理費用減少281仟元及研發費用增加1,667仟元。
本期淨利	358,515	14.5	361,236	14.3	-2,721	-0.8	本期淨利季減2,721仟元，主要為營業利益增加16,300仟元、兌換損失增加40,893仟元、股利收入增加8,175仟元、出售資產收入增加3,113仟元及所得稅費用減少4,154仟元。

單位：新台幣仟元



現金流量表

2021年上半年現金流量

單位:新台幣仟元

	2021年Q2	2021年Q1
期初餘額	2,579,005	2,008,023
營業活動之現金流量	694,588	632,777
資本支出	-66,186	-51,879
其他	-2,073	-9,916
期末餘額	3,205,334	2,579,005
自由現金流量	628,402	580,898

1,327,365

營業活動之現金流量

資本支出

-118,065

其他

-11,989

2,008,023

2021/1/1
期初餘額

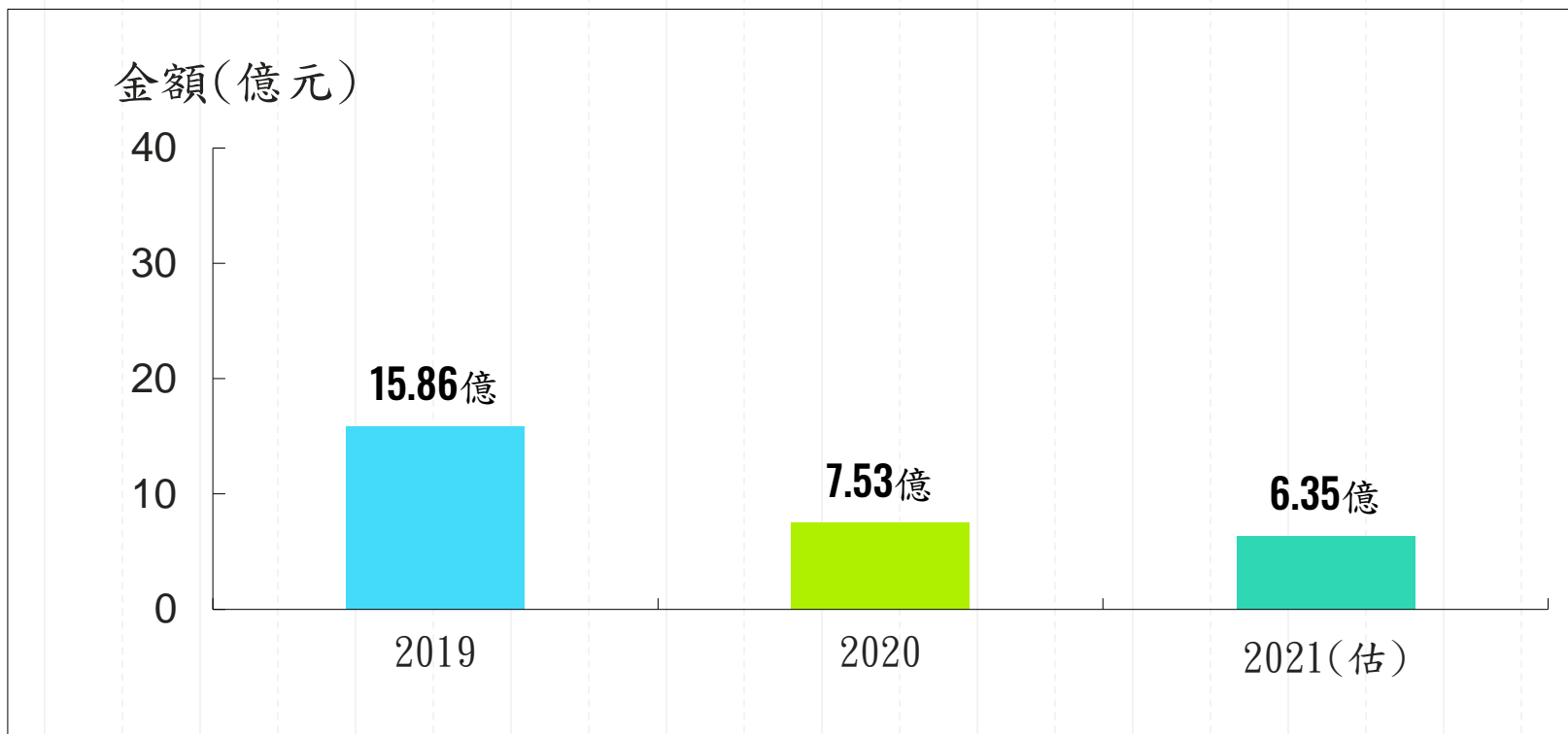
3,205,334

2021/6/30
期末餘額

2021年上半年自由現金流量為1,209,300仟元

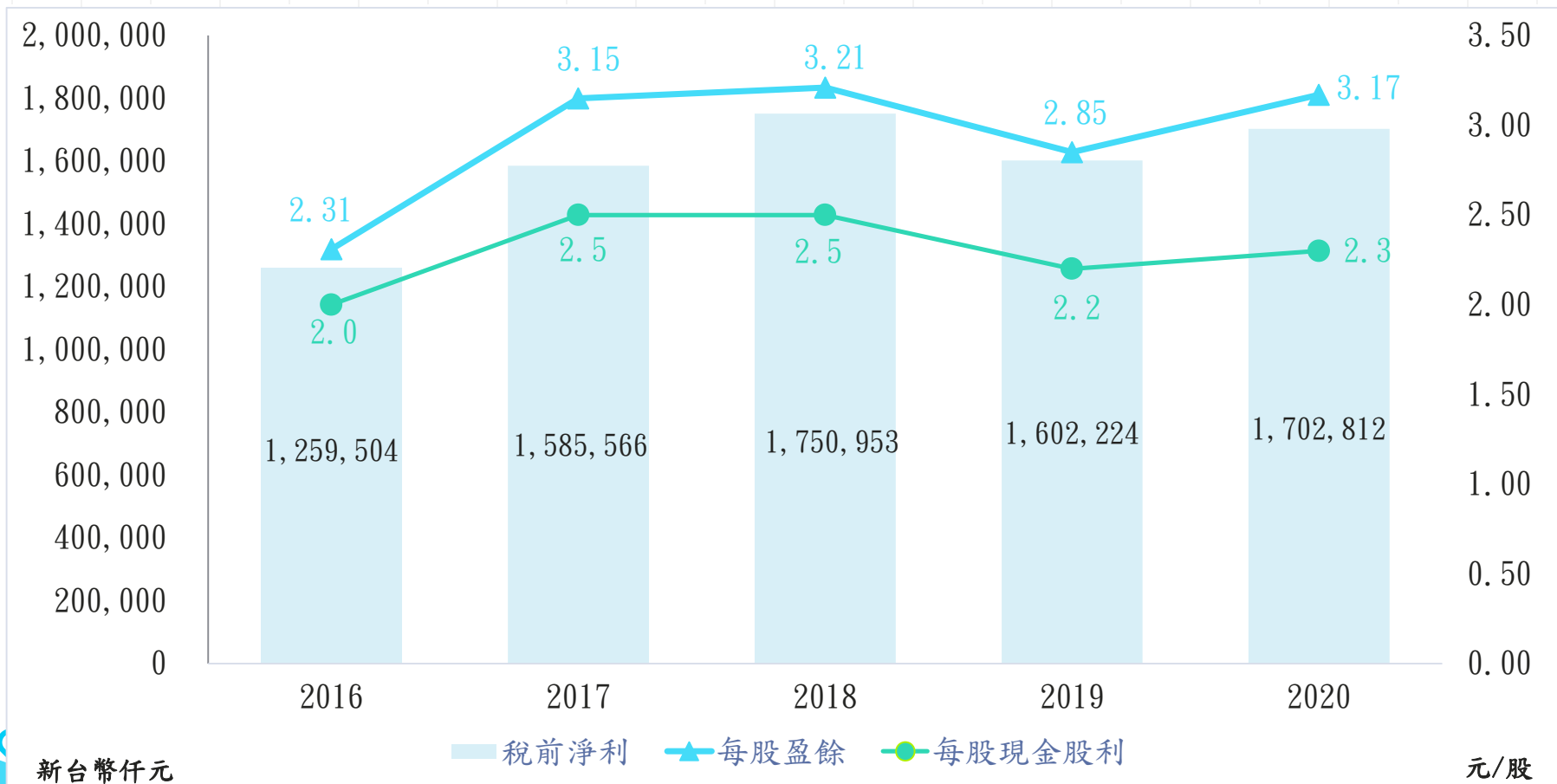


歷年資本支出





近五年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利



新台幣仟元

元/股



研究發展規劃

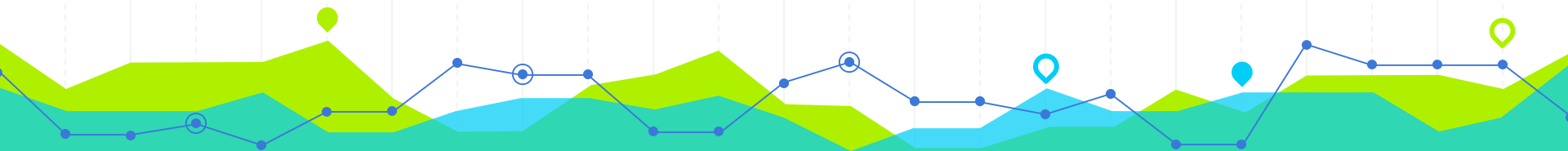
2



研究發展

在5G終端產品多功能要求下，記憶體晶片將朝高速度、高頻寬、高容量、多功能性與低耗能發展，福懋科技依此趨勢擬訂研發方向如下：

- 1 配合多功能性不同晶片封裝成單顆IC，須強化高速度度的電路設計匹配，並藉由高頻電性模擬驗證與結構應力分析等技術來達到封裝後輕、薄、短小及高效能的目標。
- 2 因應晶圓製程微縮使用低介電值材料(LOW_K)生產，將提升晶圓先切後磨、雷射切割及微間距封裝等技術。
- 3 持續應用既有的封測技術開發客戶在5G產品之封裝體代工需求。



營運重點與市場展望

3



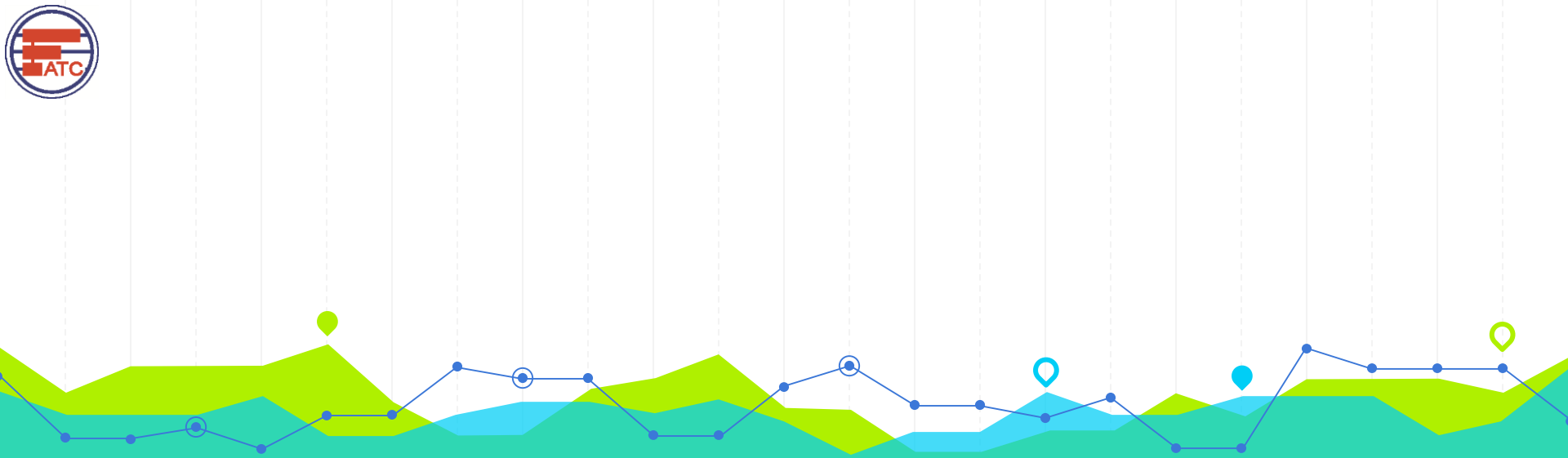
營運重點

- 1 配合客戶晶圓產能擴充及製程微縮，同步規劃擴充封裝、測試產能。
- 2 消費性記憶體、伺服器記憶體、標準型記憶體需求穩健，5G 手機比重提昇也帶動行動記憶體的需求，將配合客戶的產品組合，機動調整產能配置以符合客戶需求。
- 3 個人電腦、筆記型電腦、雲端伺服器等需求穩健，帶動記憶體模組需求升溫，將持續發揮模組系統化、自動化生產優勢爭取訂單。
- 4 佈局下世代高速記憶體產品封裝、崩應、高速測試之製程及技術。



市場展望

- 1** 疫情趨緩使得全球經濟逐步恢復成長，第三季市場需求穩健，未來市場需求審慎樂觀。但Delta病毒擴散，仍使全球經濟面臨高度不確定性，需密切注意觀察因應。
- 2** 半導體原物料供應短缺的情況衝擊電子產品供應鏈，將持續觀察材料供應情形，掌握供需動態，謹慎因應。
- 3** 5G佈建、宅經濟發酵、電動車潮流等趨勢，預期將為電子產業帶來長期發展的動能。將持續專注於新製程、新技術、新產品的開發，以符合市場趨勢並滿足客戶需求。



問與答

4



Thanks !